

わが社の「ひとわざ(一技)」PRシート

分類No: 4.基板実装

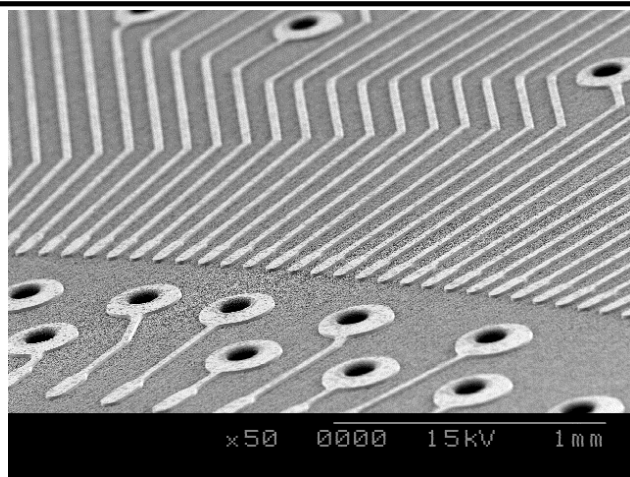
登録No: 4-078

ひとわざ(一技)名: 最新鋭の設備と固有技術による極薄・微細配線基板加工

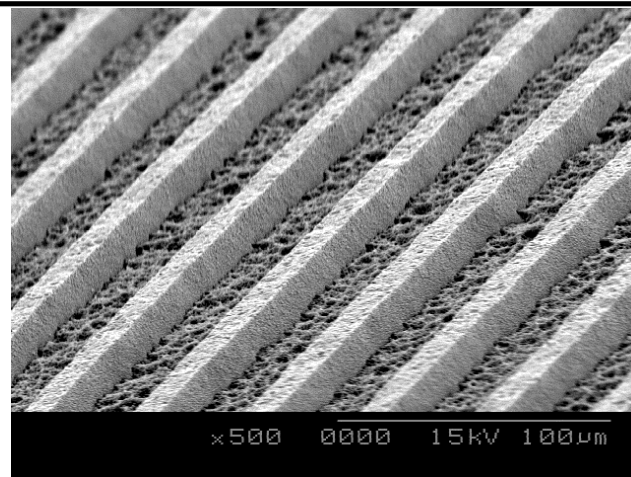
1. 概要(200字目安)

創業依頼一貫して薄板、微細配線加工技術を核として、国内半導体トップメーカー様をはじめ、国内外の半導体実装メーカー各社様との直接取引の他、半導体パッケージ基板では、世界トップに位置する基板メーカーへのOEM供給などを通して、市場の求める技術開発を行い、現在は厚み40 μ mの材料を使用した極薄基板、配線幅25 μ mの微細配線量産対応技術を確立しています。

写真・図(要点説明)



半導体パッケージ基板銅配線



微細配線:配線幅/間隔幅=25/25 μ m

2. 企業概況

会社名	株式会社 リョウワ		代表者名	五味 健			
			窓口担当	営業管理部 久保川			
事業内容	プリント基板製造・販売		U R L	http://www.ryowacoltd.co.jp			
主要製品	・半導体パッケージ基板 ・COB基板						
住所	〒391-0216 長野県茅野市米沢245						
電話/FAX	0266-73-5470 / 0266-73-3803		E-mail	kubokawa@ryowacoltd.co.jp			
資本金(百万円)	78.5	設立年月日	1982年 9月	売上(百万円)	2,400	従業員数	125人

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③取引実績 他

- ① ISO9001:2008認証取得済み
ISO14001:2004認証取得済み
- ② 半導体パッケージ基板製造ノウハウを活用した高品質プリント基板
- ③ 主要取引先 国内 株式会社東芝セミコンダクタ&ストレージ社
株式会社ジェイデバイス
株式会社ミットヨ
海外 ChipMOS(台湾、上海)
LINGSEN(台湾)
SEOUL SEMICONDUCTOR(韓国)